

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2024-006

深南电路股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况

深南电路成立于 1984 年，始终专注于电子互联领域，经过 40 年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路行业首家国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。根据 2023 年第四季度 PrismaMark 行业报告显示，2023 年公司在全球印制电路板厂商中位列第八。

1) 印制电路板（含封装基板）行业发展情况

根据 PrismaMark 2023 年第四季度报告统计，2023 年以美元计价的全球 PCB 产业产值同比下降 15.0%。

从中长期看，产业将保持稳定增长。2023-2028 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 5.4%。从区域看，全球各区域 PCB 产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率达 4.1%。从产品结构看，封装基板、18 层及以上的高多层板、HDI 板将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为 8.8%、7.8%、6.2%。

2023-2028 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2022	2023E		2028E	2023-2028E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	3,369	-4.8%	3,206	3,855	3.8%
欧洲	1,885	-8.3%	1,728	2,002	3.0%
日本	7,280	-16.5%	6,078	7,904	5.4%
中国大陆	43,553	-13.2%	37,794	46,180	4.1%
亚洲（日本、中国大陆除外）	25,654	-19.3%	20,710	30,472	8.0%
合计	81,740	-15.0%	69,517	90,413	5.4%

数据来源：PrismaMark 2023 Q4 报告

对于封装基板产品，一方面人工智能、云计算、智能驾驶、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展，驱动电子产业对高端芯片和先进封装需求的大幅增长，从而带动了全球封装基板产业在长期保持增长，尤其是推动了应用于高算力、集成化等场景的高阶封装基板产品呈较高增速的态势。另一方面，国内加大对半导体产业发展的支持力度，相关投资增加将进一步加速国内封装基板产业发展。从短期看，随着终端厂商半导体库存逐步回归正常水平，世界半导体贸易统计组织（以下简称“WSTS”）预计 2024 年全球半导体市场将同比增长 13.1%。

对于 PCB 产品，服务器和数据存储、通信、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。从云端看，随着人工智能的加速演进，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，驱动了对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热 PCB 产品需求的快速增长。从终端看，随着 AI 在手机、PC、智能穿戴、IOT 等产品的应用的不断深化，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来爆发式增长。在上述趋势驱动下，终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的持续增长。

2) 电子装联行业发展状况

电子装联在行业上属于 EMS 行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。

2023 年以来，全球多个国家、地区生产物流有所恢复，叠加下游终端客户持续去库存，电子产业的芯片与其他电子元器件供应环境改善明显。

(3) 主营业务分析

2023 年全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观形势更加复杂多变。世界银行最新研究显示，2023 年全球 GDP 增速进一步下降至 2.6%，增速较 2022 年下降 0.5 个百分点。电子产业受宏观经济下行叠加下游企业去库存影响，整体需求承压。

报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，降低了需求下行的冲击。在市场拓展层面，公司充分把握新产品开发与客户库存回补等订单机会，并通过紧抓高速通信、数据中心、汽车电子、半导体封装基板等领域中的结构性机会，持续

优化产品结构。在运营管理层面，公司持续推动数字化与智能制造转型，开展系统级降本控费，提升了运营效率。在绿色可持续发展层面，公司围绕碳排放中长期目标，持续探索、建立、完善产品全生命周期碳排放管理体系，积极开展系列节能减碳行动，推进绿色低碳发展。

报告期内，公司实现营业总收入 135.26 亿元，同比下降 3.33%；归属于上市公司股东的净利润 13.98 亿元，同比下降 14.81%。上述变动主要由于下游市场需求下行，封装基板和 PCB 业务全年整体稼动率较上年同期有所下降，叠加封装基板新项目建设、新工厂爬坡等带来的费用和固定成本增加等因素影响。

1) 印制电路板业务积极推进产品结构优化

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 80.73 亿元，同比下降 8.52%，占公司营业总收入的 59.68%；毛利率 26.55%，同比下降 1.57 个百分点。

通信领域，2023 年国内市场需求仍未出现明显改善，海外市场下半年以来项目节奏有所放缓，导致相关需求后延。据专业机构 Dell'oro 最新研究，2023 年上半年以来全球电信行业资本支出放缓。报告期内，公司通信领域订单整体规模同比有所下降，公司积极应对挑战，主动优化产品结构，结合一系列成本优化举措，降低了通信市场需求弱化带来的影响。海外项目开发及产品导入工作取得进展，公司在海外客户处的订单份额保持稳定。

数据中心领域，2023 年全球主要云服务厂商整体资本开支规模下降，导致服务器整体需求下滑。专业研究机构 Omdia 指出 2023 年全球服务器预计出货量为 1,140 万台，同比下降 19%。报告期内，公司数据中心领域同比微幅增长，主要为下半年以来部分客户 Eagle Stream 平台产品逐步起量，以及在新客户与部分新产品（如 AI 加速卡等）开发上取得一定突破。

汽车领域，根据专业研究机构 Marketline 数据显示，2023 年全球新能源车销量同比增长近 30%。公司充分把握了新能源和 ADAS 方向的增长机会，全年汽车领域订单同比增长超 50%。订单增量主要来自公司前期导入的新客户定点项目需求的释放，以及 ADAS 相关高端产品的需求上量。此外，海外 Tier 1 客户开发工作进展顺利，为未来汽车业务的持续增长奠定了坚实基础。

报告期内，PCB 业务通过细化流程和平台管理加强成本费用管控，不断强化数字化水平、提升制程能力，增强 PCB 业务技术与成本竞争力。

2) 封装基板业务发力存量市场深耕与新客户开发

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 23.06 亿元，同比下降 8.47%，占公司营业总收入的 17.05%；毛利率 23.87%，同比下降 3.11 个百分点。

2023 年上半年全球半导体行业景气较弱，下游客户产品库存调整周期拉长，下半年以来部分领域需求有所修复。WSTS 统计数据显示，2023 年全球半导体销售额同比下滑近 11%。公司通过深耕存量市场、开发新客户等多措并举，保障了营收的基本稳定。报告期内毛利率有所下滑，主要由于行业需求回落导致稼动率下降，叠加新项目建设及新工厂爬坡，费用和固定成本增加。

市场机会和产品导入方面，公司凭借广泛的 BT 类基板产品覆盖能力与针对性的销售策略把握了需求回暖机遇，其中存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长。

技术能力突破方面，公司 FC-CSP 产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平；RF 产品成功导入部分高阶产品；FC-BGA 14 层及以下产品现已具备批量生产能力，部分客户已完成送样认证，处于产线验证导入阶段；14 层以上产品已进入送样认证阶段。

新项目建设方面，无锡基板二期工厂持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程。广州封装基板项目一期建设推进顺利，已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。报告期内，无锡二期基板工厂爬坡和广州封装基板项目建设带来的成本和费用增加对公司利润造成一定负向影响。

3) 电子装联业务发力多领域开发，实现逆势增长

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 21.19 亿元，同比增长 21.50%，占公司营业总收入的 15.67%；毛利率 14.66%，同比增加 1.51 个百分点。

2023 年，公司电子装联业务持续开发与深耕医疗、数据中心、汽车等领域，推动营收增长。医疗领域，公司凭借行业领先的技术与服务提升了客户粘性；数据中心领域，公司通过提供具备高附加值服务和高竞争力的制造能力，争取到了更

多的优质项目；汽车电子领域，公司持续强化专业产品线竞争力建设，支撑了海外头部 Tier 1 客户开发与其项目的成功定点。

内部运营上，公司通过升级自动物流与加强精细化管理等举措提升了人员效率。此外，供应链方面，公司通过整合供应渠道、提供多元化物料选型建议等为客户提供更多价值。通过上述举措，有效助力了电子装联业务实现毛利率的改善。

4) 深入落实数字化转型，持续聚焦价值释放

2023 年公司继续深入推进流程变革与数字化转型工作，深化落实从制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化全面建设，透明化管理能力显著提升。通过数字化手段赋能，公司进一步提升了质量管理能力和生产经营效率，促进了内部精益持续改善。从结果看，2023 年以来公司持续发力挖掘智能制造和数字化的价值，通过减少异常、减少报废、减轻人员负荷、提升生产效率，有效降低了相关成本。报告期内，公司获评为 2023 年国家智能制造试点示范企业，南通公司获评为 2023 年江苏省智能制造示范工厂，并入围了 2023 第二届中国标杆智能工厂百强榜。

5) 研发创新能力稳步提升，关键产品技术实现突破

公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，持续加大研发投入规模，不断提升研发和创新能力。报告期内，公司研发投入占营收比重为 7.93%，同比提升 2.07 个百分点。公司各项研发项目进展顺利，通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板平台能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进并取得阶段性进展。新增授权专利 95 项，新申请 PCT 专利 6 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平。

6) 积极践行碳中和发展理念，持续推动节能降耗

公司响应双碳目标与绿色发展理念的号召，多措并举持续推动节能降耗。公司采用虚拟仿真、智能化柔性制造、能源管理系统等一系列数字化技术，提升生产效率、监控管理能耗，有效降低了碳排放。2023 全年综合能耗下降 5.1%，能耗费用下降 950 万元。报告期内，公司积极探索提升绿电能源比例的途径，在无锡、南通园区启动屋顶光伏建设项目，装机容量各约 4 兆瓦，年内已部分建成并投入试运行阶段。

公司碳减排成果广受各界认可，2023 年获评深圳碳排放交易所绿色低碳先锋企业、西门子客户零碳先锋奖、中国证券报第一届国新杯 ESG 金牛奖碳中和 50 强等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	22,606,867,760.88	20,726,545,628.78	20,732,418,282.96	9.04%	16,792,291,128.17	16,799,129,690.52
归属于上市公司股东的净资产	13,183,740,540.64	12,249,407,783.16	12,251,659,553.96	7.61%	8,516,936,681.69	8,517,680,074.99
	2023 年	2022 年		本年比上年增	2021 年	

				减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,526,425,962.45	13,992,454,035.04	13,992,454,035.04	-3.33%	13,942,521,948.74	13,942,521,948.74
归属于上市公司股东的净利润	1,398,114,737.36	1,639,730,777.66	1,641,239,155.16	-14.81%	1,480,637,000.32	1,481,380,393.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,953,922.58	1,498,362,669.88	1,499,871,047.38	-33.46%	1,271,642,082.90	1,272,385,476.20
经营活动产生的现金流量净额	2,589,283,004.69	3,179,833,339.56	3,179,833,339.56	-18.57%	2,341,812,030.05	2,341,812,030.05
基本每股收益(元/股)	2.73	3.22	3.22	-15.22%	3.02	3.02
稀释每股收益(元/股)	2.73	3.21	3.22	-15.22%	3.01	3.01
加权平均净资产收益率	11.07%	14.70%	14.71%	-3.64%	18.70%	18.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,784,716,084.29	3,249,062,435.29	3,427,714,678.06	4,064,932,764.81
归属于上市公司股东的净利润	206,418,890.89	267,513,151.92	434,207,104.64	489,975,589.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,010,568.97	246,662,614.34	311,504,913.34	260,775,825.93
经营活动产生的现金流量净额	689,574,962.52	530,260,583.47	330,095,900.99	1,039,351,557.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股	61,645	年度报告披露日前	64,508	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前一个月未表决权恢复的优先	0
----------	--------	----------	--------	----------	---	----------------------	---

东总数		一个月末 普通股股 东总数		复的优先 股股东总 数		股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际 控股有限 公司	国有法人	63.97%	328,068,670	0	不适用	0	
香港中央 结算有限 公司	境外法人	3.04%	15,584,770	0	不适用	0	
中国人寿 保险股份 有限公司 —传统— 普通保险 产品— 005L— CT001 沪	其他	1.30%	6,653,487	0	不适用	0	
国新投资 有限公司	国有法人	0.78%	3,994,565	0	不适用	0	
李雪红	境内自然 人	0.58%	2,970,000	0	不适用	0	
华芯投资 管理有限 责任公司 —国家集 成电路产 业投资基 金二期股 份有限公 司	其他	0.54%	2,787,585	0	不适用	0	
山东省国 有资产投 资控股有 限公司	国有法人	0.42%	2,176,900	0	不适用	0	
中国人寿 保险股份 有限公司 —万能— 国寿瑞安	其他	0.39%	1,994,946	0	不适用	0	
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.30%	1,558,859	0	不适用	0	
中航产业 投资有限 公司	国有法人	0.27%	1,393,792	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	中航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司受同一控制方控制，公司未知其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	股东李雪红通过信用交易担保证券账户持有 2,970,000 股，实际合计持有 2,970,000 股						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

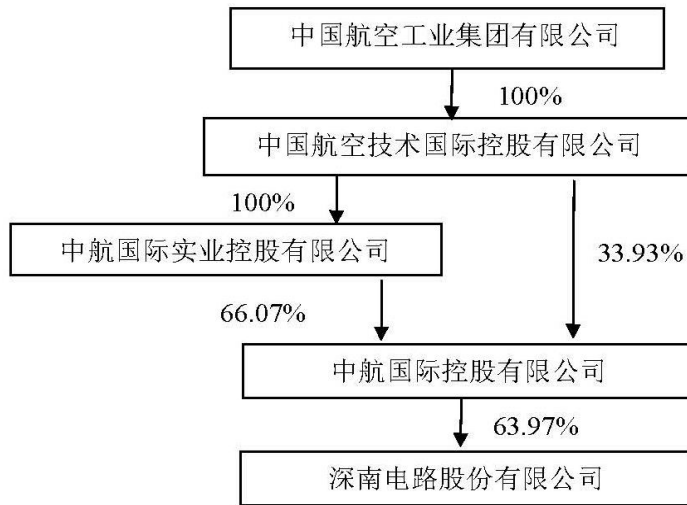
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	新增	0	0.00%	6,653,487	1.30%
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	新增	0	0.00%	1,994,946	0.39%
GIC PRIVATE LIMITED	新增	0	0.00%	1,558,859	0.30%
中航产业投资有限公司	新增	0	0.00%	1,393,792	0.27%
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉全球成长 1 期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	289,800	0.06%
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	退出	0	0.00%	167,841	0.03%
挪威中央银行—自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。